

SEMICON JAPAN 2008 出展いたしました
(小間番号:2C-705/Hall2)

SEMICON[®]
Japan2008

当社は、12月3日(水)～5日(金)の3日間、幕張メッセにおいて開催される『[セミコン・ジャパン2008](#)』に出展し、国内最大の実績を有する当社の半導体装置のリース・ファイナンス事業と、[スミックス株式会社](#)の中古半導体装置売買事業、そして同社の誇る技術サービス事業とのコラボレーションにより推進しているトリニティー・サービスについてご紹介いたしました。

多数のご来場、誠にありがとうございました。



今年の様子

【開催概要】

名称 : [セミコン・ジャパン2008](#)
会期 : 2008年12月3日(水)～5日(金) 10:00-17:00
会場 : 幕張メッセ 千葉市美浜区中瀬2-1
(1～11ホール、イベントホール、国際会議場) 小間番号:2C-705 ホール2
主催 : SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International)

お問合せ窓口
三井住友ファイナンス&リース株式会社
電子デバイス設備部
TEL:03-3515-1940/FAX:03-3515-1959
Mail:semicon@smfl.co.jp

以 上